



頌勝科技材料股份有限公司

2026年Q2法人說明會

Precision | Vision | Innovation

連結全球產業鏈，開創半導體材料新未來

2026.08.14



免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息，係本公司蒐集外部經濟發展現況並整合內部資料後所得，僅反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性，故實際營運結果、財務狀況以及業務展望可能與前瞻性資訊有所差異，其原因來自於各種公司所不能掌控的風險。
- 本公司對於前瞻性資訊不作任何聲明或保證，除非法令另有要求外，本公司亦不因新資訊、未來事件或其他情事變更事由，負有主動更新前瞻性資訊的義務。



CONTENTS

簡報大綱

01 | 財務表現

02 | 營運概況及未來展望



綜合損益表-2026 2Q vs 2026 1Q vs 2025 2Q

綜合損益表項目

(除另予註明者外，金額以新台幣仟元)

	2026 2Q	2026 1Q	2025 2Q	季變化	年變化
營業收入淨額	570,679	558,892	539,590	+2.11%	+5.76%
營業毛利率	52.08%	55.77%	48.14%	-3.70%	+3.93%
營業費用	203,097	196,105	158,103	+3.57%	+28.46%
營業淨利	94,096	115,608	101,668	-18.61%	-7.45%
營業淨利率	16.49%	20.69%	18.84%	-4.20%	-2.35%
營業外收入及支出	52,063	29,583	(76,642)	+75.99%	+167.93%
歸屬予母公司業主之本期淨利	114,221	99,753	11,307	+14.50%	+910.18%
純益率	20.35%	18.38%	2.54%	+1.96%	+17.81%
每股盈餘(新台幣元)	1.70	1.62	0.19	0.08	1.51

綜合損益表-2026Q2 vs 2025Q2 vs 2025年度

綜合損益表項目

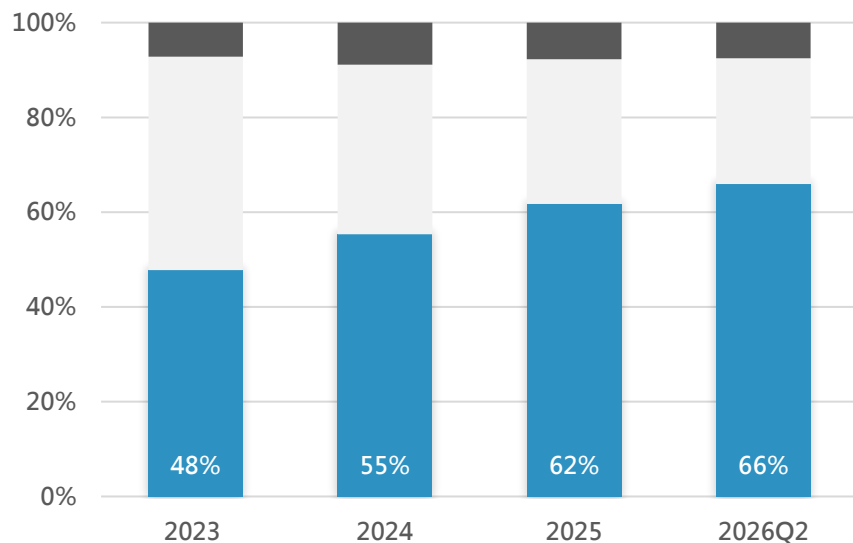
(除另予註明者外，金額以新台幣仟元)

	2026/1-6月	2025/1-6月	2025年度	年變化
營業收入淨額	1,129,571	1,018,796	1,980,776	+10.87%
營業毛利率	53.91%	50.45%	50.92%	+3.46%
營業費用	399,202	323,405	694,208	+23.44%
營業淨利	209,704	190,559	314,365	+10.05%
營業淨利率	18.56%	18.70%	15.87%	-0.14%
營業外收入及支出	81,646	(67,680)	(27,535)	+220.64%
歸屬予母公司業主之本期淨利	213,974	78,410	191,182	+172.89%
純益率	19.37%	8.17%	10.09%	+11.21%
每股盈餘(新台幣元)	3.32	1.35	3.24	1.97

經營績效

產品結構優化驅動毛利率持續上升

■ 半導體研磨墊與耗材 ■ 醫療與運動產品 ■ 環保黏著劑等



半導體產品營收占比變化

48% → 55% → 62% → 66%

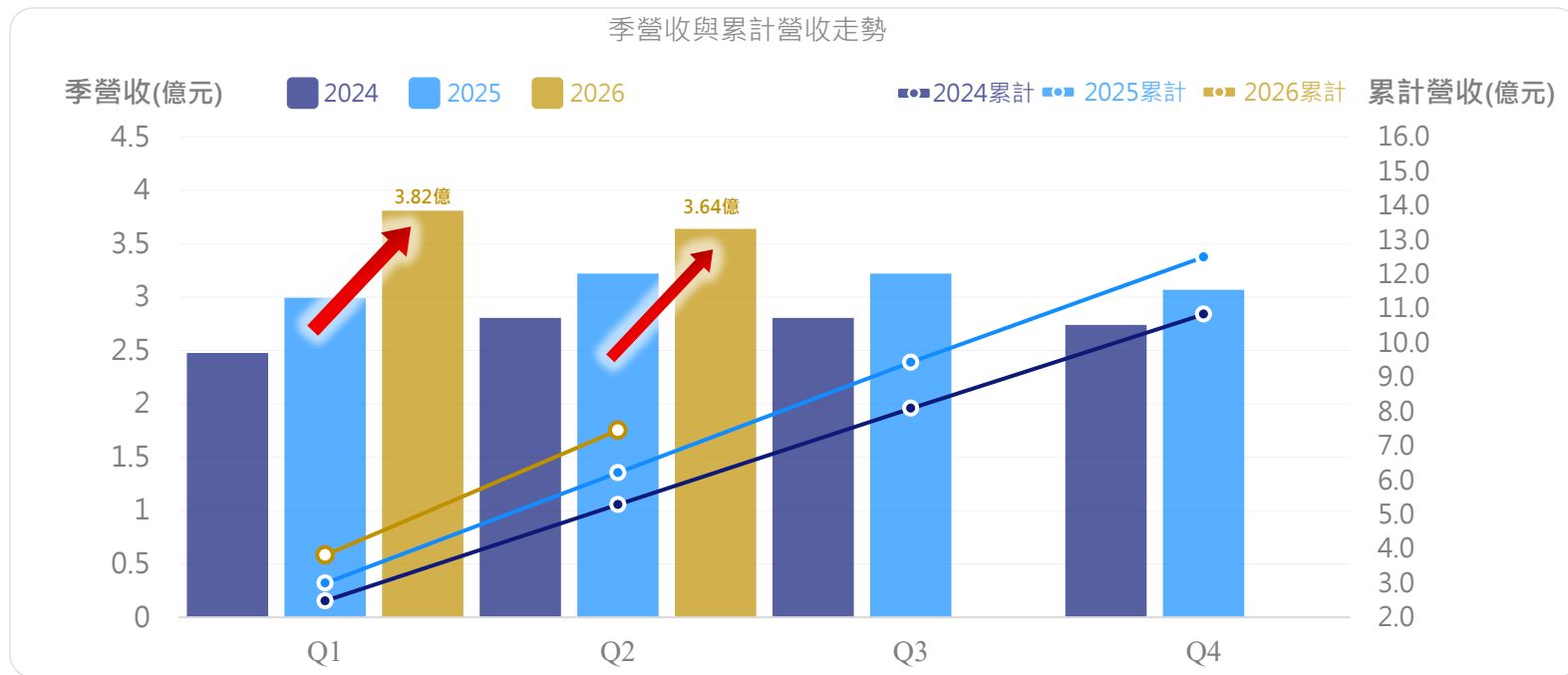
整體營業額成長動能

CAGR 25%

2023-2025營業複合成長率

經營績效

半導體業務趨勢：穩基礎、降波動、強成長



2024 – 2025：營收穩定，累計營收呈現穩定趨勢

2025：季節性效應低，營收波動變小，可預測性提升

2026：成長動能明確

經營績效

半導體業務：高基期穩成長，新動能再加速

2024 平均YoY

36%

高成長

2025 平均YoY

15%

穩延續

2026 平均YoY

25%

再加速

月營收(億元)

2024

2025

2026

YoY

1.5

1

0.5

0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

70%

50%

30%

10%

-10%

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

- 連續三年平均維持雙位數成長
- 延續 2024 年 36% 的高基期，2025 年關稅變數下仍維持 15% 穩健成長
- 2026 年隨新動能發酵，下半年成長動能再度放大

資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目
(新台幣仟元)

	2026/6/30		2025/6/30		年變化
	金額	%	金額	%	
現金及有價金融商品投資	3,210,788	46.56%	1,404,184	44.20%	+128.66%
應收帳款	383,721	5.56%	394,461	12.42%	-2.72%
存貨	451,692	6.55%	338,496	10.66%	+33.44%
不動產、廠房及設備	2,378,802	34.50%	714,016	22.48%	+233.16%
其他	470,628	6.83%	325,397	10.24%	+44.63%
資產總計	6,895,631	100.00%	3,176,554	100.00%	+117.08%
流動負債	1,256,381	18.22%	1,336,290	42.07%	-5.98%
長期負債	1,117,381	16.20%	178,994	5.63%	+524.26%
負債總計	2,373,762	34.42%	1,515,284	47.70%	+56.65%
股東權益總計	4,521,869	65.58%	1,661,270	52.30%	+172.19%
重要財務指標					
流動比率(倍)	3.30		1.61		+105.28%
負債比率	34.42%		47.70%		-27.84%
平均收現日數	113.55		124.34		-8.68%

現金流量表

(新台幣仟元)

	<u>2026/1-6月</u>	<u>2025/1-6月</u>
期初現金	902,437	608,680
營運活動之現金流入	117,672	53,854
資本資出	(915,906)	(102,273)
投資	(609,911)	(7,155)
現金增資	2,670,567	704,704
舉借借款(償還借款)	155,549	(169,969)
其他	19,957	(25,635)
期末現金	2,340,365	1,062,206

股利政策

2023-2025年度股利發放政策

年度	加權平均流通在 外股數(仟股)	EPS	現金股利	資本公積發 放現金	合計
2025	70,065	3.24	2.455	1.045	3.5
2024	60,000	4.42	3.45	-	3.45
2023	51,992	0.90	0.59	1.41	2.0

近三年股利維持穩定配發，最低配發率78%



CONTENTS

簡報大綱

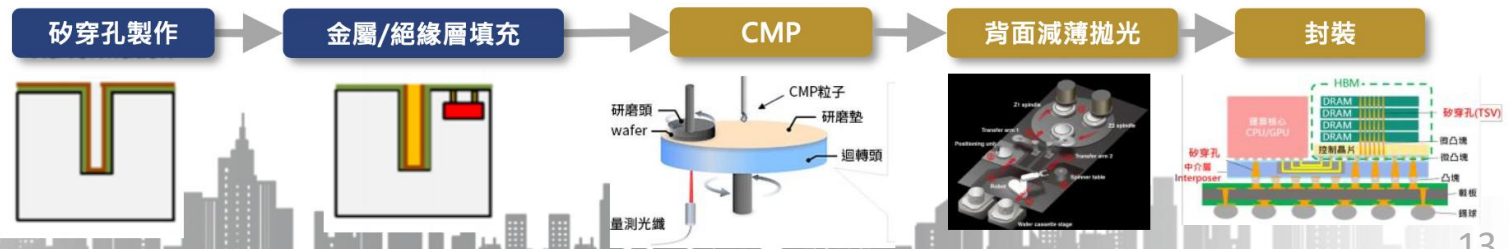
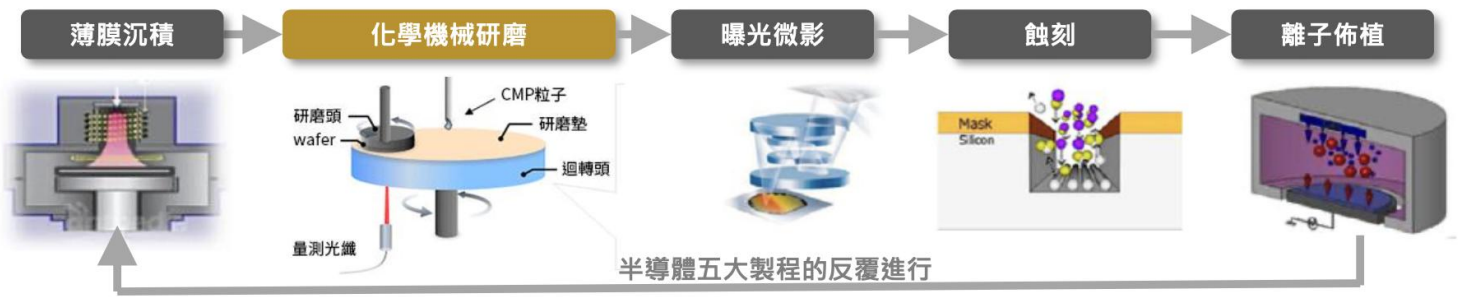
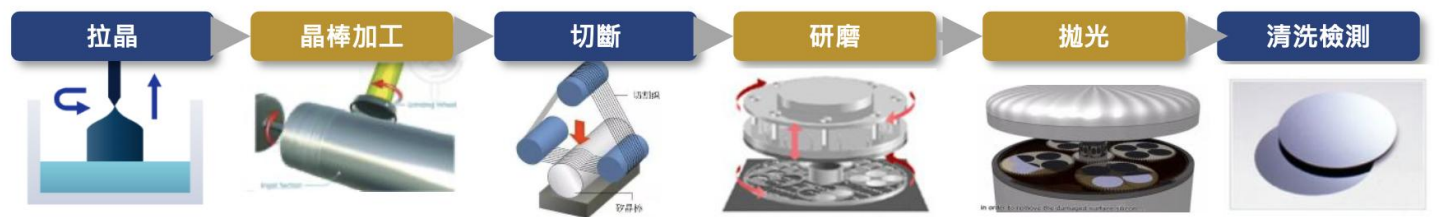
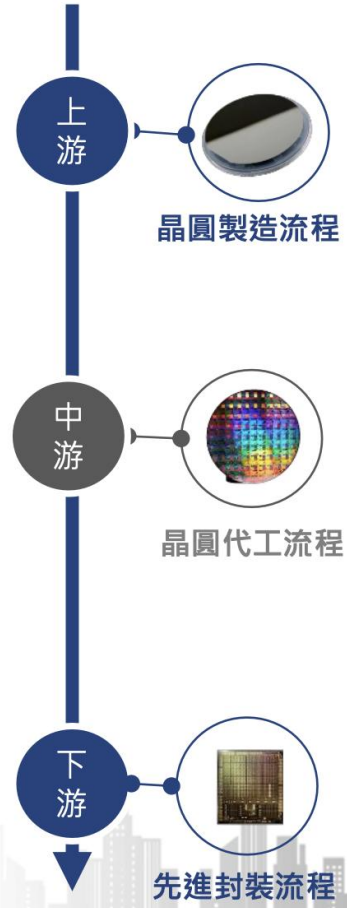
01 | 財務表現

02 | 營運概況及未來展望



市場機會

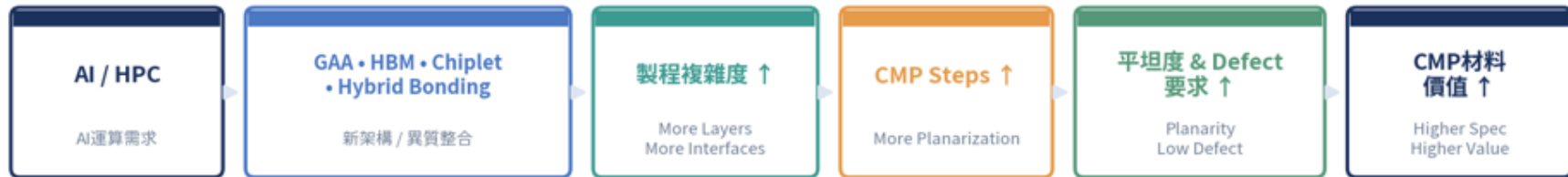
洞悉市場關鍵機會:研磨拋光全鏈應用



01 | INDUSTRY INFLECTION

AI時代，CMP從製程環節走向關鍵材料

AI驅動新架構與異質整合，推升製程複雜度、CMP使用次數與材料規格要求



AI不是直接帶來CMP成長，而是透過新架構與異質整合，讓平坦化成為更多關鍵製程的必要條件。

「製程越先進、結構越複雜，CMP的重要性與使用次數越高。」

02 | APPLICATION EXPANSION

CMP研磨與平坦化的應用版圖持續擴大

從先進邏輯、記憶體與封裝，延伸至晶圓、玻璃、中介層與下一世代材料

Advanced Logic

GAA / BEOL
Backside Power

Advanced Memory / HBM

DRAM / 3D NAND
TSV / Stacking

Advanced Packaging

Chiplet / RDL
2.5D / 3D

Hybrid Bonding / Interposer

Cu-to-Cu / Dielectric
中介層研磨

Wafer Manufacturing

長晶廠晶圓研磨
Wafer Polishing

Glass & Next-generation Materials

玻璃研磨 / Glass Interposer
新材料研磨

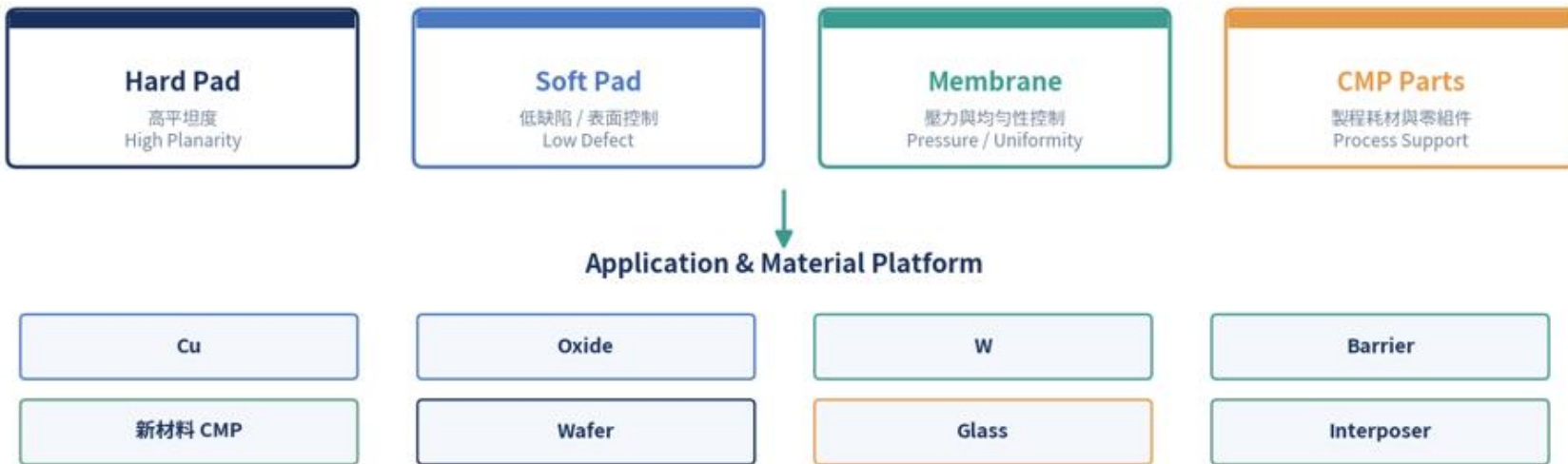
頌勝科技面對的不是單一CMP市場，而是一個持續擴張的「精密平坦化」應用版圖。

Advanced Semiconductor → Advanced Packaging → Wafer / Glass / Interposer → Next-generation Materials

03 | PRODUCT PORTFOLIO EXPANSION

從單一Pad走向多元CMP Product Portfolio

產品線從研磨墊延伸至Membrane與CMP Parts，並對應更多材料與精密研磨應用



Single Product → Multi-product Portfolio → Higher Customer Value

擴大產品組合 × 擴大應用範圍 × 提升客戶服務深度

04 | WHY PVI TECHNOLOGY

為什麼是頌勝科技？40多年累積的材料、配方、製程技術核心能力

40+ Years of Material, Formulation & Process Technology Expertise

從原料、配方、產品、製程到應用，關鍵技術自主掌握



「40多年累積的不只是製造經驗，而是從材料、配方、產品設計、製程技術到客戶應用的完整技術 Know-how。」

05 | BEYOND MOORE'S LAW

從材料供應商走向「共同定義下一世代製程」

異質整合與新架構快速發展，材料商的角色正從「符合既有規格」走向「與客戶共同制定新規格」



「當下一世代製程尚未有既定答案，材料供應商的價值，就從『符合規格』走向『與客戶共同定義規格』。」

Material Supplier → Technology Co-development → CMP Total Solution Partner

06 | CORE COMPETENCE

頌勝科技如何把40多年Know-how轉化為CMP解決方案

從材料設計、產品結構到製程整合與客戶共同開發，形成可持續累積的技術能力



材料設計 × 孔洞結構 × 硬度 × Groove Design × Slurry / Pad / Conditioner / Equipment 整合驗證

「材料決定極限，設備決定上限。」

CMP Total Solution Partner

40+ Years Know-how → Integrated Technology Capability → Customer Value

07 | CAPACITY • R&D • AUTOMATION

提前布局產能、研發與自動化，準備承接全球成長

因應未來布局與產能需求，頌勝科技積極擴建工廠及研發中心、投入新設備並導入自動化



頌勝科技已經在為下一階段成長投資



「擴產不只是增加產能，更是同步提升品質、製程穩定度、交付能力與全球客戶服務能力。」

08 | GLOBAL EXPANSION

From Taiwan to the World | 從台灣走向全球

以台灣累積的材料、配方、製程技術與製造能力為基礎，逐步建立服務全球客戶的技術與供應平台

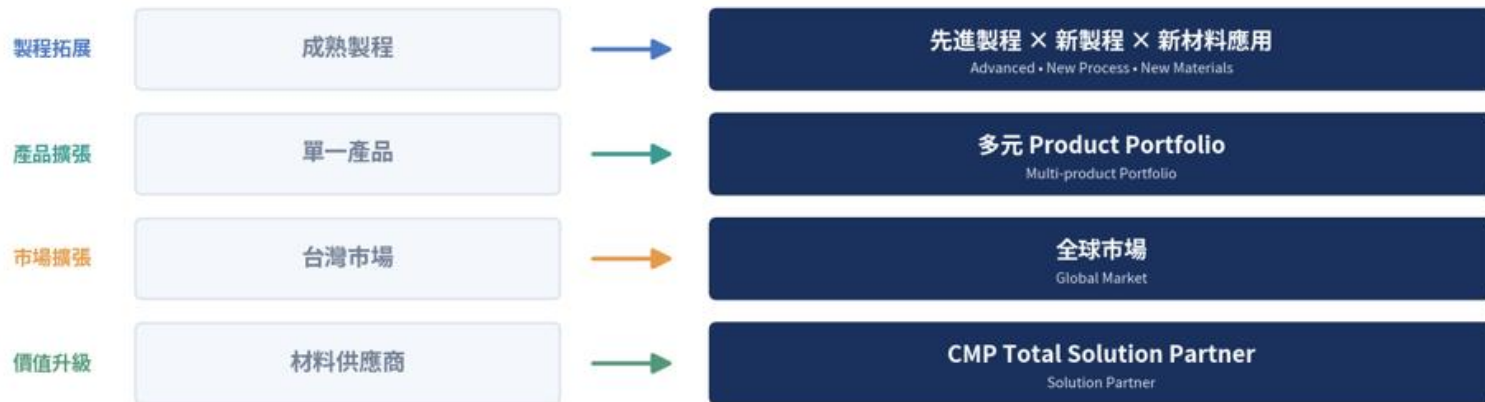


「以台灣建立的核心能力為起點，逐步擴大全球客戶、全球技術服務與全球供應能力。」

09 | NEXT GROWTH BLUEPRINT

頌勝科技下一階段成長藍圖

製程拓展 × 產品擴張 × 全球化 × 解決方案能力，形成下一階段四大成長方向



40+ Years Know-how → New Process & Product Expansion → Customer Co-development → Global Growth

AI與異質整合推動CMP走向更多新製程、新材料與高階應用。
憑藉40多年材料、配方與製程技術，頌勝科技將與客戶共同開發、從台灣走向全球，掌握長期成長機會。

市場機會與策略

台灣與中國的雙策略引擎

China

中國觀勝合肥新廠
中國市場擴張

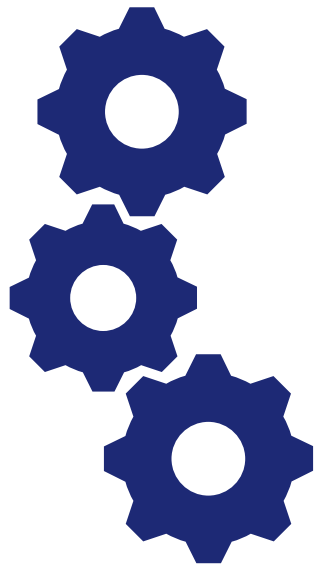


Taiwan

台灣中科研發中心
全球市場



未來成長三引擎－半導體材料市場



引擎一：台灣新廠及研發中心擴大

- 預計每年需增加25%以上產能
- 加碼投資研究中心，擴大與客戶先進技術方面之合作
- 提早佈局新技術發展之產品應用
- 預計於2027Q2啟動中科新廠

引擎二：CMP Soft Pad新產線

- 已於2024Q4設立新產品生產線
- 預計2026Q3試產、認證
- 預計2026Q4逐步量產

引擎三：觀勝合肥投資案

- 已於2024/03取得設立登記核可
- 已於2024/07注資，2024Q3動工
- 已於2026/6/17開幕
- 預計2026Q3試產、認證
- 預計2026Q4逐步量產

市場機會與策略

多層策略堆疊

ASP 平均銷售單價

搶佔未來技術的制高點

先進製程驅動價值躍升

鞏固基石與橫向發展

前瞻新技術

實現一開始就進入的紅利，搶佔先機

先進製程

與頂尖客戶進行深度合作開發，提升產品ASP

先進封裝

已有產品正式量產

晶背供電 | 共同封裝光學 (CPO) | TGV

既有產品- 橫向展開到新應用

將成熟產品導入全新應用領域

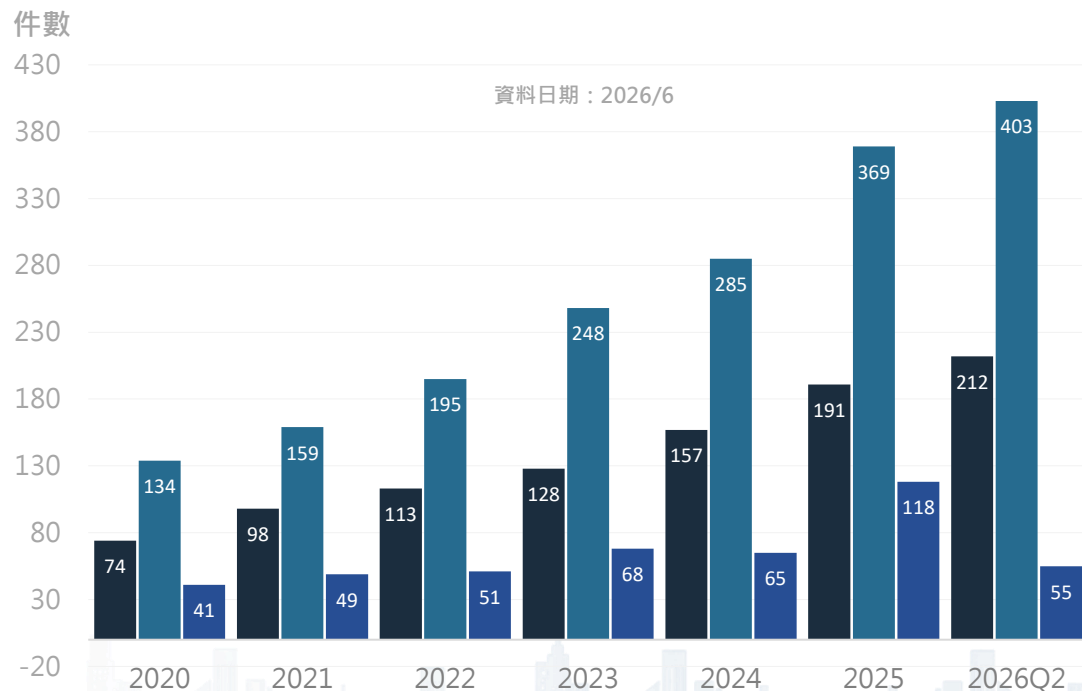
化合物半導體 | 散熱基板 | 矽光子(SiPh)

既有產品- 受惠於地緣政治供應鏈重組

受惠於「地緣政治」帶來的供應鏈重組

市場機會與策略

量產品穩定成長，研發數持續開案



新開專案
8.2% 55件

研發中專案
60.2% 403件

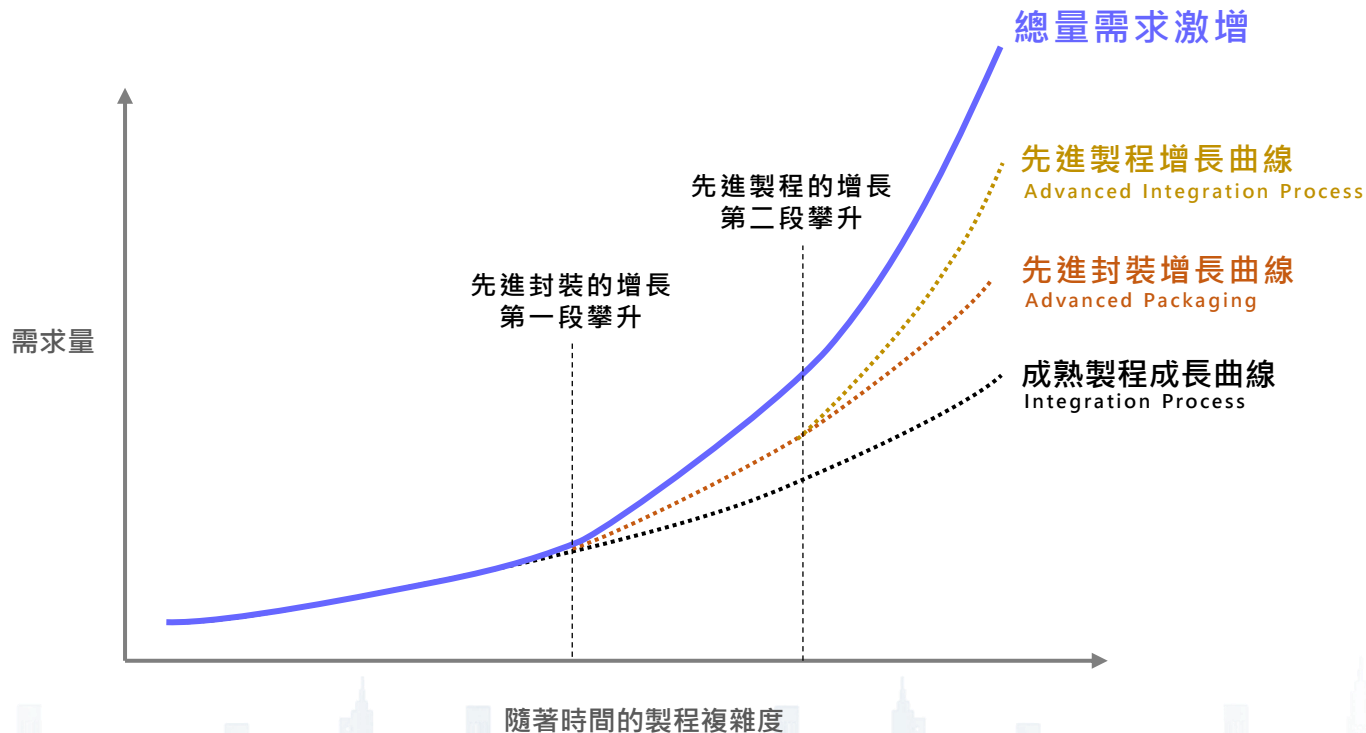
量產品
31.6% 212件

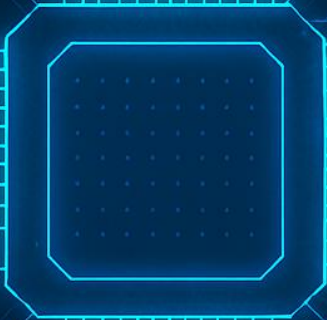
重點

- 量產品穩定增長
- 研發專案合作案持續轉量產
- 訂單逐步放大，推升營收

市場機會與策略

成熟製程 | 先進封裝 | 先進製程 的用量攀升三曲線





CMP is

Create Many
Possibilities

PVI on the Way